

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-129

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）及子公司提供担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的100%，前述担保主要系公司或其全资子公司对全资子（孙）公司、控股子公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）、苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司对控股子公司上海精积微、苏州精材向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过20,000万元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、项目贷款、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
精测电子	上海精积微	上海精测直接持股 27.2168%	42.32%	9,000	10,000	2.64%	否
	苏州精材	北京精材直接持股 100%	57.14%	2,700	10,000	2.64%	否

注：（1）上表中精测电子最近一期净资产为公司截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净资产；

（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 9 月 30 日财务数据计算得出。

二、被担保人基本情况

1、上海精积微半导体技术有限公司

成立时间：2021年5月12日

注册资本：45,927.5万元人民币

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路2855弄1-72号B座12层D区1207室

法定代表人：马骏

经营范围：一般项目：半导体、计算机、显示屏、光伏、锂电池、新能源、检测设备、测试设备科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；普通机械设备安装服务；以下范围限分支机构经营：生产检测设备、测试设备；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备销售；电工仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海精测半导体技术有限公司	12,500	27.2168
2	上海精望企业管理中心（有限合伙）	10,000	21.7734
3	海宁市精海股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000	10.8867
4	上海半导体装备材料产业投资基金合伙	2,500	5.4434

	企业（有限合伙）		
5	上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,500	5.4434
6	上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,500	5.4434
7	苏州芯兆创业投资合伙企业（有限合伙）	2,250	4.8990
8	南京创盈盛通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,950	4.2458
9	共青城红晔未石精集创业投资合伙企业（有限合伙）	1,650	3.5926
10	上海科技创业投资（集团）有限公司	1,577.50	3.4348
11	厦门建达芯全股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250	2.7217
12	嘉兴浦测股权投资合伙企业（有限合伙）	1,250	2.7217
13	海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2.1773
合计		45,927.50	100

与公司关系：为公司的控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2024 年度（单位：元）	2025 年 9 月 30 日（单位：元）
资产总额	346,707,278.54	403,554,149.55
负债总额	153,764,265.56	170,767,927.40
净资产	192,943,012.98	232,786,222.15
营业收入	51,043,244.37	84,593,025.31
利润总额	-98,978,034.41	39,843,209.17
净利润	-98,978,034.41	39,843,209.17

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、苏州精材半导体科技有限公司

成立时间：2023 年 7 月 3 日

注册资本：6,500 万人民币

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区启明路 8 号综合

保税区 B 区 H 厂房

法定代表人：吴涛

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成：公司控股子公司北京精材半导体科技有限公司持有 100%股权

与公司关系：为公司的控股孙公司

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2024 年度（单位：元）	2025 年 9 月 30 日（单位：元）
资产总额	61,829,815.06	63,627,325.42
负债总额	29,744,171.68	36,355,532.04
净资产	32,085,643.38	27,271,793.38
营业收入	650,000.00	12,476.50
利润总额	-14,343,165.76	-18,913,850.00
净利润	-14,343,165.76	-18,913,850.00

经查询中国执行信息公开网，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。子公司作为被担保对象经营情况

良好，资产质量优良，偿债能力较强。上述被担保人为公司全资孙公司或控股子公司，公司未要求其提供反担保。公司控股子公司其他股东未按其享有的权益提供同等比例担保，系由于公司对该控股子公司在经营管理、财务、投资等方面均能有效控制，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。上述担保行为不会损害公司利益，担保风险可控，不会对公司及子公司产生不利影响。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 86,311.5 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2024 年 12 月 31 日净资产的 24.92%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日